

成都华微电子科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻“以投资者为本”的核心理念，切实维护全体股东权益，基于对公司未来发展潜力的坚定信心、对企业价值的深度认同以及履行社会责任的使命担当，公司于 2024 年 4 月制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。通过全年扎实有效的执行，公司在经营效率提升、市场竞争力强化、投资者权益保障及资本市场形象塑造等方面取得显著成效。为延续发展动能，公司于 2025 年启动新一轮规划，制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。该方案既对 2024 年实施成果进行全面总结，又制定能进一步提升公司经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益、树立良好资本市场形象的相关举措。具体情况如下：

一、聚焦主营业务发展，全面提升核心竞争能力

过去一年中，公司始终坚持“成为国家级集成电路科研、生产龙头企业和骨干力量，助力国家特种集成电路行业的长远发展”的愿景。公司以技术赋能为核心竞争力，通过技术优势驱动产品竞争力升级，精准捕捉市场机遇；依托产品矩阵优化战略，持续完善多元化产品布局，满足客户个性化需求，市场认可度稳步提升；通过强化市场渗透与客户拓展策略，扩大客户群体规模。这一成果源于战略定力与团队协作的双重驱动，公司在 2024 年全年共实现营业收入 60,388.99 万元，实现归属于上市公司股东净利润 12,216.99 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 8,761.70 万元。

1、持续推动创新，加强研发投入与成果转化

在 2024 年度，公司研发支出占营业收入的比例为 25.46%，较上年同期增加 4.06 个百分点。在主营业务方向上新申请发明专利 31 件，集成电路布图设计 28 件，软件著作权 11 件；新获授权发明专利 9 件，集成电路布图 31 件，软件著作权 11 件。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计获得发明专利 119 项，集成电路布图设计权 221 项，软件著作权 40 项，实用新型专利 11 项。公司研发人员占公司总人员比例为 42.78%。

公司在特种集成电路领域持续深耕，打造了健全且高效的研发体系。公司始终将研发工作置于核心地位，对产品及技术研发布予高度重视并持续投入大量资源。凭借这种专注与投入，公司成功构建了一系列拥有自主知识产权的核心技术成果。在 FPGA、高速高精度 ADC、智能 SoC 等关键领域，公司承担并出色完成了多项国家重点研发计划和科技重大专项任务。凭借这些成就，公司在特种集成电路设计行业中脱颖而出，其整体技术储备稳居行业第一梯队，展现了强大的技术实力和行业竞争力。

2024 年度内，公司最新研制的已集成高性能 CPU、AI 加速单元 NPU、eFPGA 等组件的相关产品，如 HWD109XX 系列和 HWD090XX 的 SoC 类产品，已进入样品用户试用验证阶段。在 MCU 方面，公司推出了自主研发的 32 位高速高可靠 MCU “HWD32H743”，其运行频率高达 400MHz，具备强大的双精度浮点数字信号处理能力，拥有高达 2MB Flash 和 512KB SRAM，广泛应用于工业控制、电机控制、AIOT、机器人和智能设备等领域。在高速高精度 ADC 这一重点研发方向上，公司研制的 12 位 8GSPS、8 位 64GSPS 高速 A/D 转换器均已实现量产供货。

公司将继续围绕高性能 FPGA、高速高精度 ADC、智能 SoC 等领域，持续加大对研发投入，打造数模混合信号高端集成电路设计平台。公司重点投入的研发项目进展与预计取得的成果如下：

序号	项目名称	2024 年投入金额（万元）	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高性能 FPGA	4836.67	已形成五百万门到七千万门级 FPGA 谱系化产品；已形成集成高速 ADC/DAC 的 RF-FPGA 产品；在研亿门级和 2.5 亿门级高性能大规模 FPGA；在研 EDA 软件开发工具。	集成高速 ADC/DAC、CPU 和信号处理定制加速单元，实现大带宽信号处理高性能处理平台。	国内领先	数据处理、5G 通信、卫星通信、人工智能加速等大带宽信号处理计算平台等领域

序号	项目名称	2024 年投入金额（万元）	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
2	高速高精度转换（ADC/DAC）芯片	3358.74	已完成 16bit 分辨率、1MSPS 以上采样率的原型样片研制和测试；已完成 4 通道 12 位 16GSPS 和 4 通道 12 位 40GSPS 高速高精度 ADC 的产品设计及仿真工作；已完成 10 位 128GSPS ADC 和 DAC 两款产品内核的仿真验证，正在进行集成 SerDes 高速接口的产品设计。	形成覆盖多通道、分辨率 8~12 位、采样率 8~128GSPS 的高速 ADC/DAC 谱系化产品，满足宽频谱射频直采先进收发系统应用需求。集成大规模 OTP 校准单元、高速高精度比较器、高精度基准源等可复用核心电路，形成兼具高采样率和高精度的 AD 转换器产品。	国际先进	工业控制、高速数据采集系统以及便携式设备等领域；电磁频谱、卫星激光通信、通感一体化，高端测控仪器等领域
3	智能异构系统（SoC）芯片	691.13	已成功研制用于边缘计算领域的人工智能芯片，AI 算力高达 16Tops，已在特种行业的多个客户里小批量试用。更高性能和更高算力的智能异构 SoC 芯片也在研发中。	集成 CPU、GPU、NPU 以及 eFPGA 等核心 IP，实现异构多核协同处理，形成高效处理标量，矢量和张量等多种计算的灵活高能效比计算平台。	国内领先	机器人、无人机、车载等嵌入式计算平台等领域。
4	微控制器芯片（MCU）	338.09	已形成低功耗、通用、高性能的低中高全系列产品体系，正在研制多核高性能计算系列微控制器。	形成特种集成电路最完整谱系产品，高性能计算在微控制器领域应用落地	国内领先	电机控制、车载等嵌入式控制领域
5	高精度数据转换（ADC/DAC）芯片	1947.98	已完成一款 32 位隔离 ADC 和一款超低噪声并带有低漂移电压基准的单通道 ADC 研制，正在进行更高采样率、更低噪声电压和集成可变增益放大器、可编程采样率和空间高可靠性设计等方面的产品扩展设计。	集成高阶调制器、可编程增益放大器、高精度基准源等可复用核心电路，形成精度高、采样率和输入范围可配置的通用 AD 转换器产品。	国内领先	工业控制、陀螺、加速度计、热电偶、环境探测等领域

序号	项目名称	2024 年投入金额（万元）	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
6	总线接口芯片	1125.05	已形成 RS232/422/485 协议、245 总线、LVDS 等接口谱系化产品；CAN 总线收发器、有源滤波器方向多款典型产品已经定型并小批量供货；正在进行隔离 485 协议芯片研发。	开发 35KV 高等级 ESD 结构、宽电源域输入端口、高数据率驱动器等设计，形成功能全面、应用灵活的接口产品库。	国内领先	信号传输、通信系统、计算机系统等领域
7	电源管理芯片	1994.44	已形成快速瞬态响应、超低噪声 LDO 电压调整器和高功率密度高效率 DC-DC 转换器谱系化产品。面向高速转换器供电的 2A 以下超低噪声 LDO 电压调整器产品已经量产，3A 以上大电流产品正在设计开发。高压 DC-DC 转换器 40V 以下已经量产，60V 及以上产品正在设计开发，600V 高压驱动电源产品正在研发。	面向高速通信和高速数据处理大电流 LDO 输出电流达到 5A，高压大功率智能驱动控制器输入电压达到 600V，高压 DC-DC 转换器耐压达到 100V。	国内领先	高速通信、数据采集、伺服控制、精密测量等领域。
8	应用验证及其他项目	1082.2	已形成飞控板、电机控制板、地检测试设备、近十款高可靠性信号处理 SiP 产品，正在研制新一代高算力辅助信号处理 SiP 芯片等。已成功研制 DDR3、DDR4、2GnorFlash，达到供货阶段，在研的 eMMC、NVRAM 已进入初样阶段。	形成特种集成电路信号处理 SiP、系统板卡以及控制电路 SiP、系统板卡的核心供应商；形成特殊集成电路通用存储器产品，并辅助 SiP 类产品开发研制以及应用。	国内一流	特种行业电子系统化、小型化，高可靠性应用；覆盖特种集成电路行业高算力系统应用中的存储器。

2、以市场机遇为导向，加强新客户拓展与深化老客户合作并举

在过去的这一年里，公司始终紧密关注客户的个性化需求，积极应对客户反馈以及市场的变化，并且迅速调整研发策略，以此来提升研发效率，确保能够满足行业实际的需求。与此同时，公司还非常注重加强销售网络的建设工作，组建

起了一支具备丰富专业经验的技术支持团队，主要目的是为客户提供技术验证以及应用服务支持。此外，在长期的业务协作过程中，公司与下游合作伙伴建立了坚实的信任基础，这为公司的持续发展奠定了稳固的基石。为进一步加强市场部门在新客户的拓展和老客户的深度合作上，公司在济南、上海、西安和长沙等地设立了研发中心或分公司，以便持续关注前沿技术的发展趋势，切实跟进市场以及客户的需求，保障市场部门与研发部门之间能够通力合作并且快速响应。通过这些举措，公司进一步深入挖掘客户的需求，有力地推动了新产品和技术研发的进程，进一步巩固了公司在特种集成电路设计行业内的领先地位，为公司的可持续发展注入了强大动力。

二、加速推进募投项目的实施，增强公司的科技创新实力

2024 年 2 月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额约为人民币 15 亿元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目累计投入 50,479.98 万元（未包含补充流动资金项目部分），针对“芯片研发及产业化”项目，公司 2024 年共投入 14,436.74 万元，投资进度为 19.25%，未来公司将继续就高性能 FPGA、高速高精度 ADC、自适应智能 SoC 等三个方向的产品研发进行持续投入，尽早完成产品研发并实现产业化。在“高端集成电路研发及产业基地”项目上，公司 2024 年共投入 36,043.24 万元，投资进度为 65.53%，其项目预计将于 2027 年 2 月达到预定可使用状态，届时将建成检测中心和研发中心，助力公司打造集设计、测试、应用开发为一体的高端集成电路产业平台，强化巩固公司在特种集成电路领域的核心地位。

未来，公司将全力推动募投项目的落地实施，并不断强化对募投项目的精细化管理。在项目推进过程中，公司将严格遵循募集资金的管理规范，谨慎合理地使用资金，确保募投项目按照既定规划稳步开展。通过募投项目的顺利实施，促进公司主营业务的持续发展，实现募投项目的预期效益，进而提升公司的整体盈利水平，全方位增强公司的核心竞争力、盈利能力以及产品影响力。

三、优化公司治理体系，强化董监高培训工作

近几年随着公司快速发展、规模不断扩张，而公司所处的客观环境也随之对公司内控建设以及治理水平提出了更高层次的要求。2024 年，公司紧密围绕自

身实际经营情况以及相关法律法规,对原有管理制度进行了全面梳理,并且对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》等 26 项治理制度进行了修订或制定。在 2024 年这一年,公司董事、高级管理人员能够忠实、勤勉地履行自己的职责,积极参与了由中国上市公司协会、四川上市公司协会、上海证券交易所等监管机构组织的多场专题培训,通过这些培训不断提升自律意识,进而推动公司持续规范运作。公司一直致力于在满足内部控制要求的同时,注重管理创新,建立一套适合公司的内部控制管理体系,明确相关部门人员的职责和权限,加强公司员工的自律合规意识,推行全面管理,提倡全员参与,构建彼此连接、彼此约束的内控制度。

展望 2025 年,公司将根据新《公司法》等相关法律法规,进一步对公司治理结构以及《公司章程》等相关治理制度进行修改和完善,具体措施如下:

1、公司内部治理制度的健全与升级

在 2025 年,公司会依据新《公司法》的修订动态,紧密跟踪《上市公司章程指引》的修订与发布情况,相应地调整股东会、董事会、监事会的架构,及时对公司内部管理制度进行更新与修订,以确保公司规范运作,维护投资者的合法权益。

2、贯彻落实关键人员培训

在 2025 年,公司计划安排董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员积极参加由中国上市公司协会、四川上市公司协会、上海证券交易所等监管机构举办的培训活动。通过这些培训,确保公司内部的关键人员能够及时掌握最新的法律法规,提升其履行职责的能力,进而推动公司整体治理水平的提升。此外,公司还将持续关注资本市场的最新规则和监管趋势,并及时将相关信息传达给董事会及管理层,以确保公司与监管政策保持高度一致,积极配合资本市场的监管机制。

3、为独立董事打造优良的工作生态,完善其监督体系

公司会及时向独立董事通报经营状况及重大事件,同时提交相关文件,为独立董事履行职责创造便利条件,充分保障其知情权,增强独立董事对公司运营的

监督效能。

4、提升 ESG 管理水平，以实现可持续发展

公司高度重视 ESG 管理体系的构建，建立了完善的自上而下的管理架构，积极推动公司在环境保护、员工权益保障、公司治理等关键领域的 ESG 工作落地实施。展望 2025 年，公司将继续优化 ESG 相关绩效表现，加大创新研发力度，秉持以人为本和绿色发展核心理念，强化内部控制管理，同时积极与各利益相关方保持密切沟通，从而进一步提高 ESG 管理水平。

四、持续强化与投资者的沟通交流，增强信息披露的透明度

公司始终将投资者关系管理置于重要地位，坚定不移地贯彻“以投资者为核心”的原则，主动与投资者开展沟通交流，确保公司信息传递的及时性与准确性，认真倾听投资者的声音，积极采纳相关意见和建议，致力于为投资者提供全面且优质的服务，为打造稳定、良好的投资者关系筑牢根基。公司积极接听投资者专线电话，通过 IR 邮箱及时回复投资者的咨询，并借助“上证 e 互动”“全景网”等平台与投资者保持紧密互动。在定期报告披露后，公司会在“上证路演中心”“全景网”等平台举办投资者交流会，深入剖析公司经营业绩，对定期报告进行详细解读，助力投资者更清晰地了解公司的财务状况与业务发展态势。公司将继续严格遵守法律法规，持续优化投资者关系管理体系，提升管理水平，以实现公司价值和股东利益的最大化。

2024 年，公司在上证路演中心共举办了 3 次业绩说明会，并设立“成都华微”公众号平台，以便投资者能够及时获取公司的最新信息。在 2024 年期间，公司严格遵循《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，确保所有可能对公司股票交易价格产生重大影响的信息披露真实、准确、完整、及时，保障公司信息披露的透明度。

展望 2025 年，公司将继续完善投资者管理工作，加强与投资者的互动沟通，拓展与投资者的交流渠道。公司将依托“上证路演中心”“全景网”等平台，举办不少于 3 次投资者线上交流会。同时，公司将进一步利用公司官网以及“成都华微”公众号平台，为投资者提供多种便捷、及时的信息获取渠道，以便更好地了解公司动态。

五、注重回馈股东，增强市场信心

公司始终将投资者回报置于重要位置。在符合分红条件的情况下，综合考虑公司实际经营状况及未来发展计划，科学制定利润分配政策，积极实施现金分红，确保投资者能够切实分享公司发展成果。为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，在充分关注公司自身投资价值的基础上，进一步提升投资者回报水平。结合公司目前整体经营状况及所处发展阶段，经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配，不转增股本，不送红股。具体方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税）。截至当前，公司总股本为 636,847,026 股，据此计算，合计拟派发现金分红 12,736,940.52 元（含税）。

综合本年度现金分红方案来看，公司自上市以来已累计现金分红 84,063,807.43 元（含税）。

2025 年，公司将在年度股东会审议通过后，推进 2024 年度利润分配方案的实施。展望未来，公司将结合经营发展需求及业务战略目标，深入研究中期分红、多次分红的可行性，合理提升分红率和股息率，切实维护广大股东的合法权益，确保公司长期稳健发展，构建“持续、稳定、科学”的股东回报机制，秉持“投资者为本”的发展理念，努力为投资者创造更丰厚的回报，实现公司与投资者的互利共赢。

六、强化管理层与股东的利益绑定与共享机制

当下正值公司发展的关键时期，为实现高质量发展，公司高度重视高级管理人员的激励与约束机制建设。公司针对高级管理人员实施了与其经营绩效紧密相关的薪酬制度，该制度由固定薪资、基于业绩的年终绩效奖金和专项奖金三个部分构成。每年，公司将依据经营成果、盈利能力等关键绩效指标，结合高级管理人员及其分管业务的 KPI 完成情况，评定其年终绩效奖金和专项奖金。公司 KPI 指标全面覆盖销售业绩、订单量、利润率、客户拓展、生产规划、产品质量、研发进展、安全措施等多个方面，以全面评价公司经营状况。高管个人 KPI 需要综合其工作表现、业绩目标完成情况等因素评定。2025 年，公司将继续优化并严格执行高管薪酬方案，确保其薪酬结构与公司经营表现保持一致，进一步激励

高管团队为公司长期发展贡献力量，同时结合优化管理层与股东利益共担共享机制、探索长效激励机制等举措，强化高管责任意识，实现利益绑定，推动公司稳健前行。

七、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

公司会持续对“提质增效重回报”行动方案的落实情况进行跟踪评估，并按时履行信息披露义务。公司将继续聚焦核心业务，增强核心竞争力、盈利能力以及风险管理能力。通过优化经营管理、规范公司治理以及积极回馈投资者，公司将切实维护投资者利益，履行上市公司的责任与义务，回报投资者的信任，保持良好的市场形象，推动资本市场的平稳健康发展。

本次行动方案系根据公司当前实际情况制定的，并非对投资者的实质性承诺。未来，该方案可能会受到宏观政策调整、行业环境变化等因素的影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者关注相关风险。

成都华微电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日